

물품취급수수료 100억원 면제, 한-미 FTA의 숨은 혜택

1. 기업 및 제품소개

- Z사는 반도체 집적회로를 생산하여 연간 4억불 상당을 미국으로 수출하고, 미국과 반도체·메모리 분야에서 경쟁 구도에 있는 세계적인 반도체 업체
- 제품소개 : 전자집적회로(HS 제8542.31호)
 - 전자집적회로 수동소자 및 능동소자를 고밀도로 조합시킨 초소형 장치로서 프로세서 및 컨트롤러는 등이 있음

2. FTA 활용 전

- 일반적으로 반도체 집적회로는 세율이 0%인 물품으로서 한-미 FTA의 특혜세율을 적용받을 필요가 없다고 생각해 왔으나,
- 물품취급수수료의 혜택이 존재한다는 사실을 알게 되었고, 원산지 증명서 발급을 위한 준비에 착수

3. 장애 요소

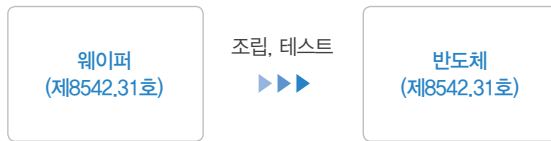
- 반도체 집적회로는 품목별원산지결정기준(PSR)이 매우 난해
 - 원산지결정기준이 '조립된 반도체 디바이스', '집적회로', '웨이퍼', '다이스' 등 전문적이고 기술적인 단어로 규정

〈 HS 제8541호, 제8542호 반도체물품 원산지결정기준 〉

: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한정한다.

1. 가. ① 조립된 반도체 디바이스, ② 집적회로 또는
③ 초소형 조립회로 : 장착되지 아니한 칩, 웨이퍼, 다이스 또는 다른 소호의 재료로부터 생산된 것
- 나. 기타 : 다른 소호에 해당하는 재료로부터 생산된 것
2. 집적법의 경우 30%, 공제법의 경우 35% 이상의 역내부가가치가 발생한 것

- 일부제품에는 세번변경도 발생하지 않아 원산지 불충족 가능성이 높음



4. 극복 방안

- **(사전 준비)** “조립된 반도체 디바이스, 장착되지 아니한 칩 등”의 ‘품명’에 대한 명확한 정의가 필요하여, 이를 위해 FTA 협정, HS 전문가 그룹인 인천세관 Dr-F T/F팀을 구성
- **(장애 해결)** Dr-F T/F팀, 관세평가분류원, A업체 반도체 연구원이 모여 해당 수출 제품의 품명에 대한 명확한 유권 해석
- **(품명 정의)** 아래의 과정이 국내에서 모두 이루어져 “가공공정기준”을 충족함을 판정
 - ① 회로패턴이 형성된 반도체 웨이퍼를 수입
 - ② 개개의 것으로 절단(다이싱)하여 개별 칩(장착되지 아니한) 생산
 - ③ 개별 칩을 가지고 조립(와이어 본딩, 몰딩작업) 수행
 - ④ 조립된 반도체 디바이스(IC, 초소형 조립회로) 생산

5. 활용 효과

- 수출인도 조건이 DDP인 경우 연간 100억원의 물품취급수수료 절감 효과는 고스란히 수출자의 혜택이 됨

6. 시사점

- 반도체 제조업체와 같이, 관세혜택이 없다고 생각하는 수출자도 FTA를 활용하여 수수료를 절감할 수 있는 것이 특징